

PASSIVE SYSTEM ALLIANCE

Prosperity Dielectrics Co., Ltd.

信昌電子陶瓷股份有限公司

2020年法人說明會

(Stock code: 6173)

報告日期:2020年8月25日

投資人關係聯絡人：發言人 羅夏盈
Email：summer_lou@pdc.com.tw
電話：03-4753355

報告內容

1. 公司概述
2. 財務績效
3. 主要市場展望
4. 營業聚焦與機會

報告內容

1. 公司概述

2. 財務績效

3. 主要市場展望

4. 營業聚焦與機會

公司概述

信昌電陶

- 成立日期 1990年6月
- 資本額 新台幣17.2 億
- 員工人數 1,203
- 品牌 PDC, Frontier (弘電)
- 營業額 2019年 NT\$43.56億(YoY:-24%)
2020 H1 NT\$24億(YoY:+1%)

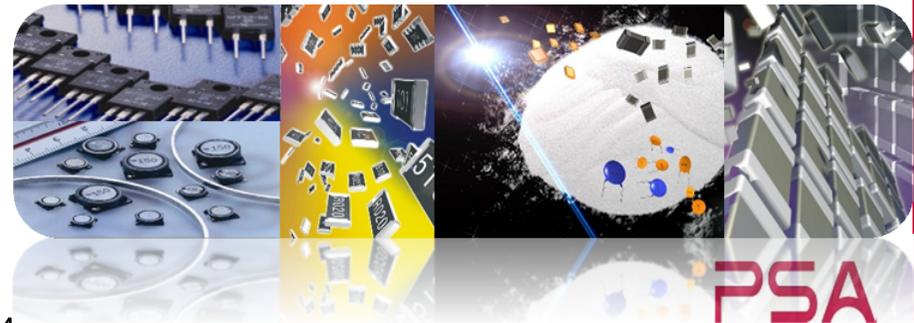


營運據點

- 台灣 桃園廠 / 楊梅廠
- 中國 吳江廠/ 永州廠/ 深圳廠/東莞辦公室

生產經歷

- Powder Since 1995 (25 years)
- MLCC/CR Since 1990 (30 years)
- Coil Since 1972 (48 years)



PASSIVE SYSTEM ALLIANCE
PROSPERITY DIELECTRICS CO., LTD.

報告內容

1. 公司概述

2. 財務績效

3. 主要市場展望

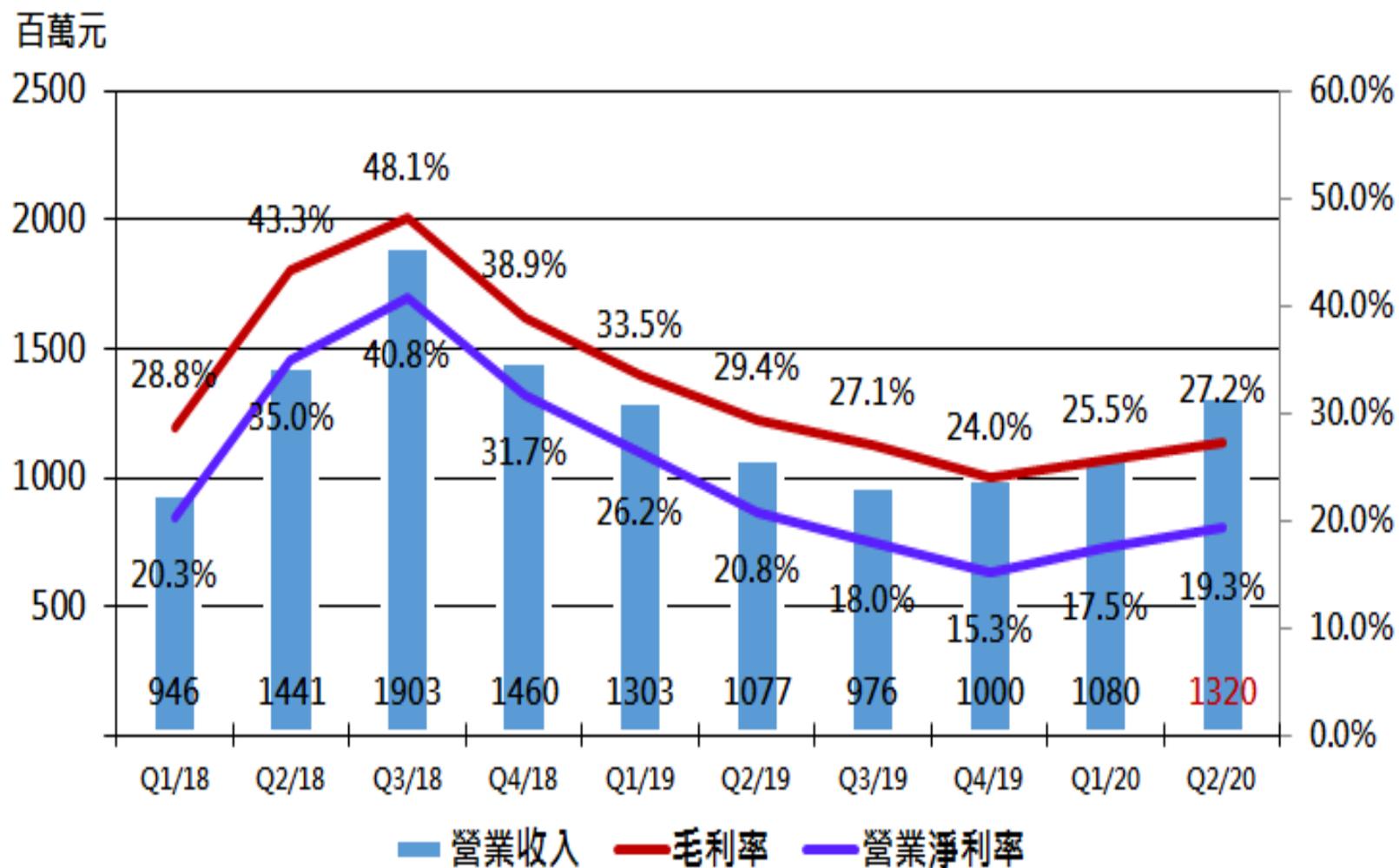
4. 營業聚焦與機會

合併綜合損益表比較

單位:台幣百萬元;每股盈餘為元

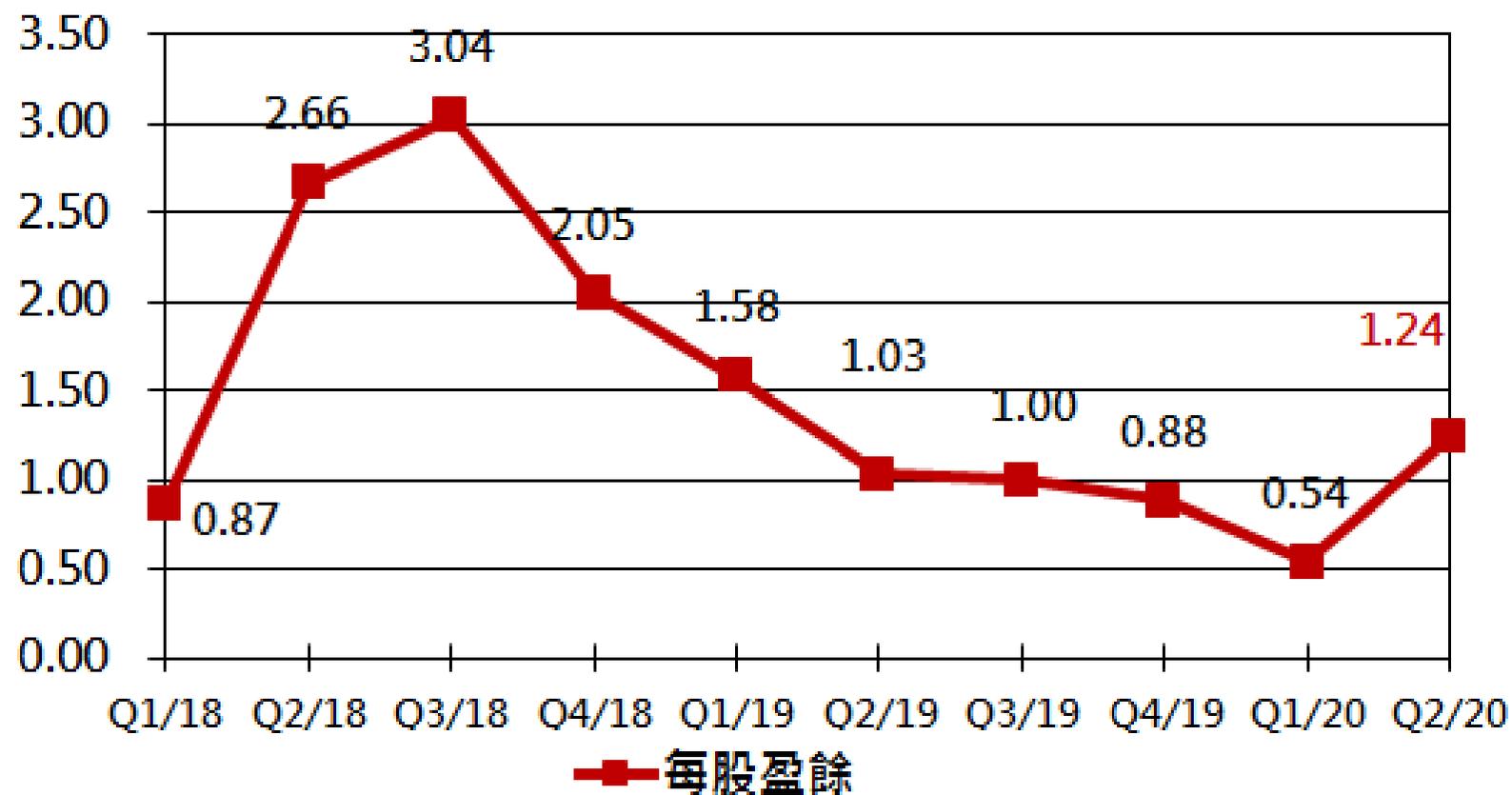
	2020 第二季	2020 第一季	QoQ	成長(%)	2020 上半年	2019 上半年	YoY	成長(%)
營業收入	1,320	1,080	239	22%	2,400	2,380	20	1%
營業毛利	359	276	84	30%	635	753	(118)	-16%
毛利率(%)	27.2%	25.5%	1.7%		26.5%	31.6%	-5.2%	
營業淨利	254	189	66	35%	443	566	(123)	-22%
營業淨利率(%)	19.3%	17.5%	1.8%		18.5%	23.8%	-5.3%	
稅前淨利	280	120	161	134%	400	587	(187)	-32%
稅後淨利	213	93	120	129%	306	449	(144)	-32%
稅後淨利率(%)	16.1%	8.6%	7.5%		12.7%	18.9%	-6.1%	
每股盈餘(元)	1.24	0.54	0.7		1.78	2.61	(0.83)	

合併營收與各項比率趨勢(各季)



每股盈餘趨勢

新台幣元



報告內容

1. 公司概述

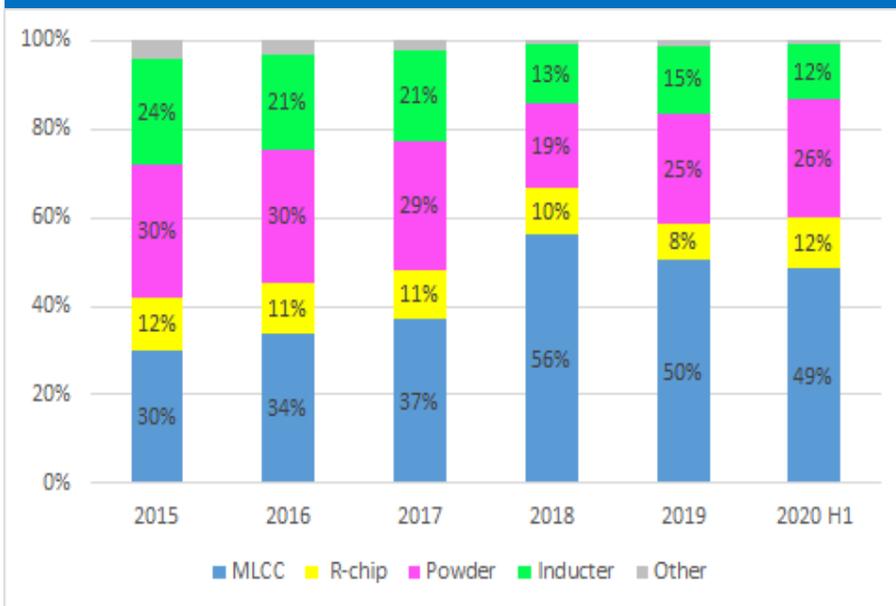
2. 財務績效

3. 主要市場展望

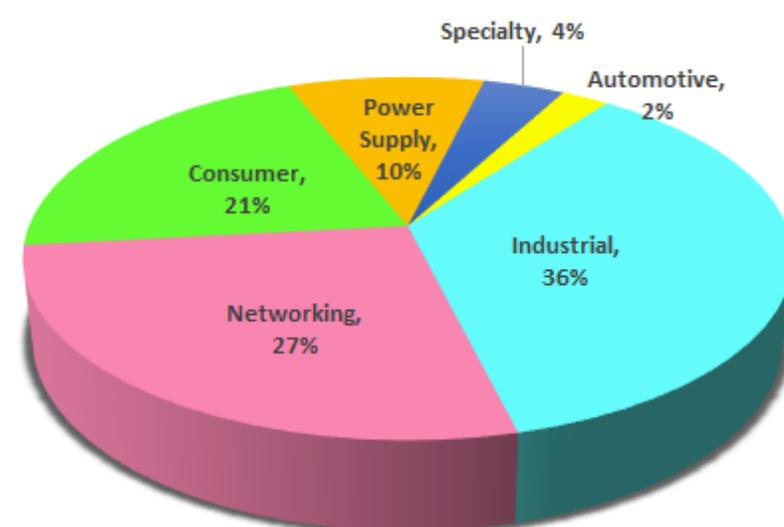
4. 營業聚焦與機會

2020 H1 營收比重

產品別銷售比重



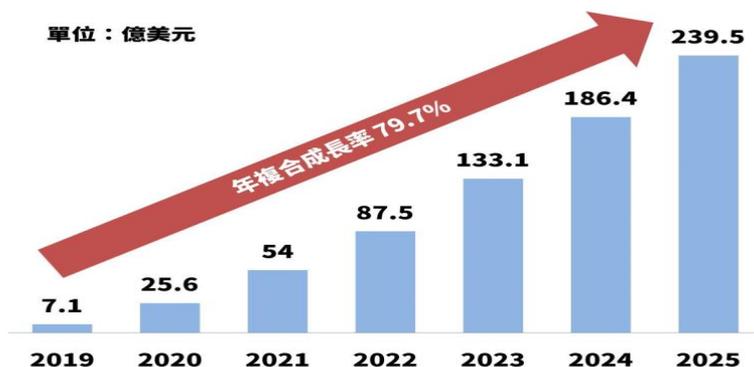
元件產品終端應用銷售比重



- 大尺寸/高功率之被動元件產品及介電陶瓷粉末為本公司主力產品。
- 終端應用主要包含網通(含5G、IOT等)、工業(含AI/航太等)及車用電子等相關產業。

市場前景-5G

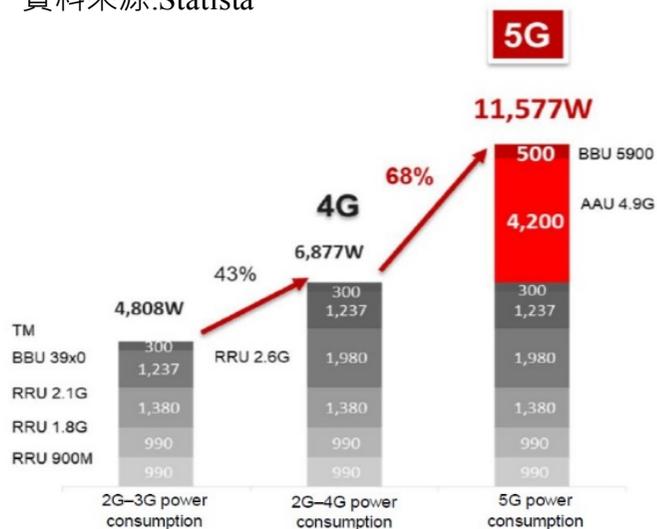
5G - 全球市場規模
估計至 2025 年將達 240 億美元



製作：Ryan / 資料來源：Statista

f CMoney 產業研究中心

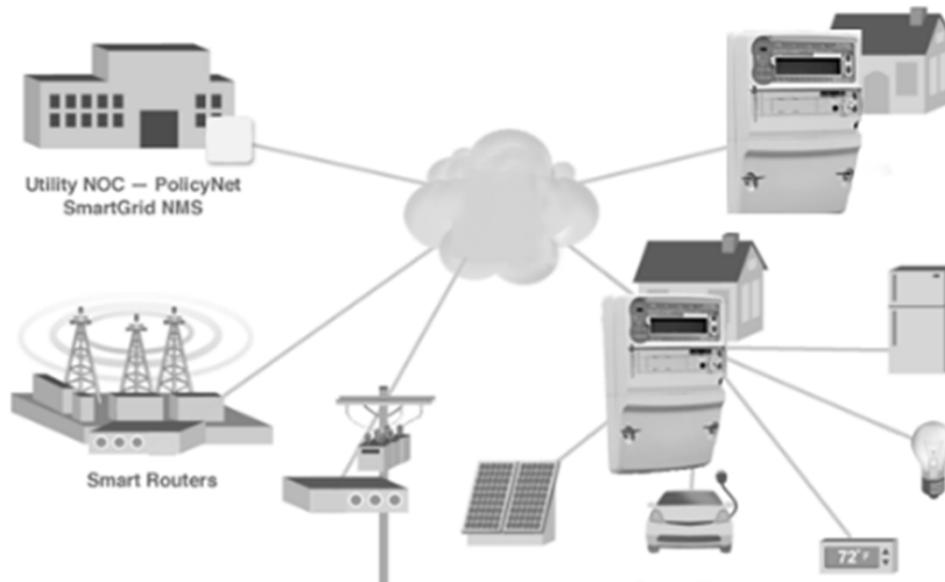
資料來源:Statista



未來主要市場成長及應用改變 對PDC產品需求趨勢

- 5G 商機 - 預估以 80% 年複合成長率高速成長,其電源模組功率將會提升.
- 隨著5G應用快速成長,其被動元件應用數量大幅增加,尤其因5G應用功率較4G大幅提升68%,相對帶動大功率被動元件需求.

信昌產品解決方案- 5G應用



Automotive/Industrial

- Big Size Mid-Volt./ High-Volt. MLCC
- Safety MLCC
- Mega cap MLCC
- Power Inductor/ Wire-Wound
- Chip Resistor
- Current Sensor Resistor

Base Station

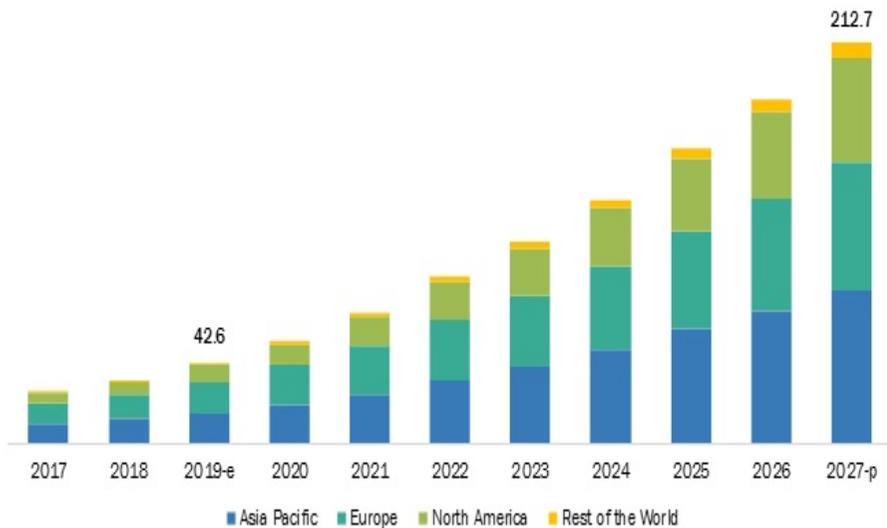
- Big Size Mid-Volt./ High-Volt. MLCC
- Power Inductor/ Wire-Wound
- Power Inductor/ Molding
- Chip Resistor
- Current Sensor Resistor

Communication

- RF Inductor
- Power Inductor/ Wire-Wound
- Power Inductor/ Molding
- Chip Resistor

市場前景-車用商機

CONNECTED CAR MARKET, BY REGION (USD BILLION)



©2019 Markets and Markets Research Private Ltd. All rights reserved.

e-estimated, p-projected

Source: Secondary Research, Expert Interviews, Company Presentations, and MarketsandMarkets Analysis

資料來源:Secondary Research

未來主要市場成長及應用改變 對PDC產品需求趨勢

- 車用商機 – 連網汽車預估以 22% 年複合成長率高速成長,其ECU,ADAS....需求之被動元件將比原燃油車增加數倍.
- 隨電動車滲透率快速提升其電池系統由原來12V轉為48V,大大提升中高電壓MLCC及大尺寸被動元件之應用.

信昌產品解決方案- 汽車電子



Body Electronics

- RF Inductor
- Power Inductor
- Big Size Mid-Volt./ High-Volt. MLCC
- Common Mode Choke
- Current Sensing Resistor

Ethernet Phy

- RF Inductor
- Power Inductor
- Big Size Mid-Volt./ High-Volt. MLCC
- Common Mode Choke

ECU

- Power Inductor
- Common Mode Choke
- Big Size Mid-Volt./ High-Volt. MLCC
- Chip Resistor

Lighting

- Power Inductor
- Big Size Mid-Volt./ High-Volt. MLCC
- Current Sensor Resistor

Infotainment

- RF Inductor
- Power Inductor
- Common Mode Choke
- Current Sensor Resistor

GPS/DVBT/BT/WiFi/FM/GSM

- RF Inductor

ADAS

- Power Inductor
- RF Inductor
- Big Size Mid-Volt./ High-Volt. MLCC
- Common Mode Choke
- Current Sensor Resistor

市場前景-第三代半導體(GaN、SiC)商機

SiC/GaN較適合高壓/高頻

比較表	Si	SiC	GaN	
能隙(Ev)	1.1	3.25	3.4	
電子飽和速度	1x	2x	2.2x	越高傳播速度越快(高頻)
介電常數	11.8	9.7	10	越小傳播延遲越少
臨界電場	1x	10x	7.3x	越高越耐高壓(高壓)
導熱係數	1.5	5	1.3	越高越耐高溫(高溫)

資料來源:Yole、福邦投顧彙整

同廠牌快充不同材質不同瓦數體積比較

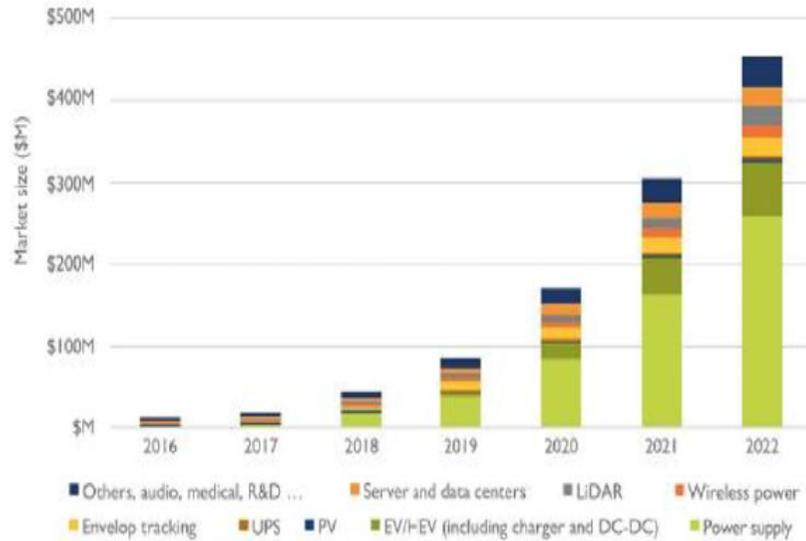


快充導入GaN(氮化鎵)MOS有小巧、高效、發熱低等特點，由於體積小內部原設計之電解電容及Disc安規電容皆改為大尺寸MLCC。

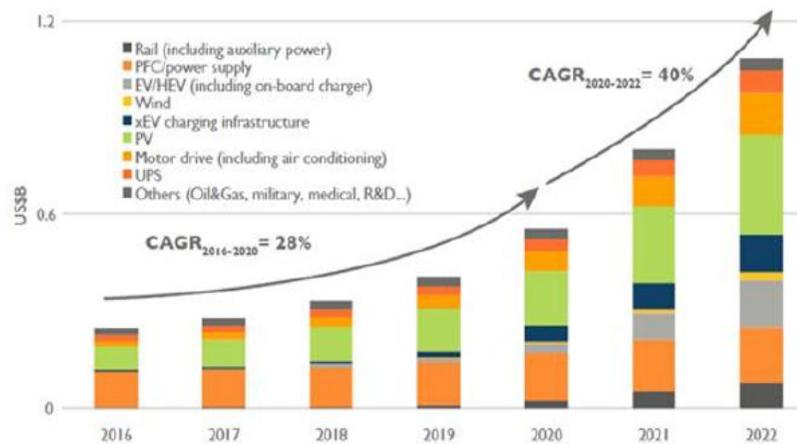
資料來源:GaNFast

市場前景-第三代半導體(GaN、SiC)商機

GaN市場規模預測(2020~2022預估CAGR60%)



SiC市場規模預測(2020~2022預估CAGR40%)



未來主要市場成長及應用改變
對PDC產品需求趨勢

- GaN/SiC 第三代半導體後續於Power, EV, Industrial...應用會大量成長,亦會帶動大功率被動元件需求。

報告內容

1. 公司概述
2. 財務績效
3. 主要市場展望
- 4. 營業聚焦與機會**

機會

- 5G應用快速帶動大功率被動元件需求增加.
- 車用商機 – 連網汽車高速成長及電動車滲透率快速提升,大大提升中高電壓MLCC及大尺寸被動元件之應用.
- GaN/SiC 第三代半導體應用大量成長,亦會帶動大功率被動元件需求.
- 由於新冠疫情持續及美中關係變化, 影響未來經濟情勢,但上述未來科技發展造成被動元件應用需求增加之趨勢不變.

營業聚焦

■ MLCC –

- 因應未來產業應用需求, 持續開發大尺寸及中高電壓之MLCC及擴充產能.
- 具材料自主開發及製程技術能力, 可有效配合中高壓及大尺寸之特殊MLCC導入高附加價值之市場, 及降低成本提升競爭力.

■ 瓷粉 –

- 持續開發高階高容MLCC應用粉末與建立高容粉末產能.
- 因應5G/AI市場成長需求, 持續開發高階應用微波粉末.
- 持續開發各系列RF元件用LTCC材料.

■ 持續透過PSA平台進行產品整合並擴大銷售.

Thank you!

本資料均屬機密，僅供指定之收件人使用，未經寄件人許可不得揭露、複製或散佈本信件。

This message and any attachments are confidential and may be legally privileged. Any unauthorized review, use or distribution by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please immediately notify the sender, completely delete this documents, and destroy all copies. Your cooperation will be highly appreciated.